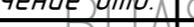
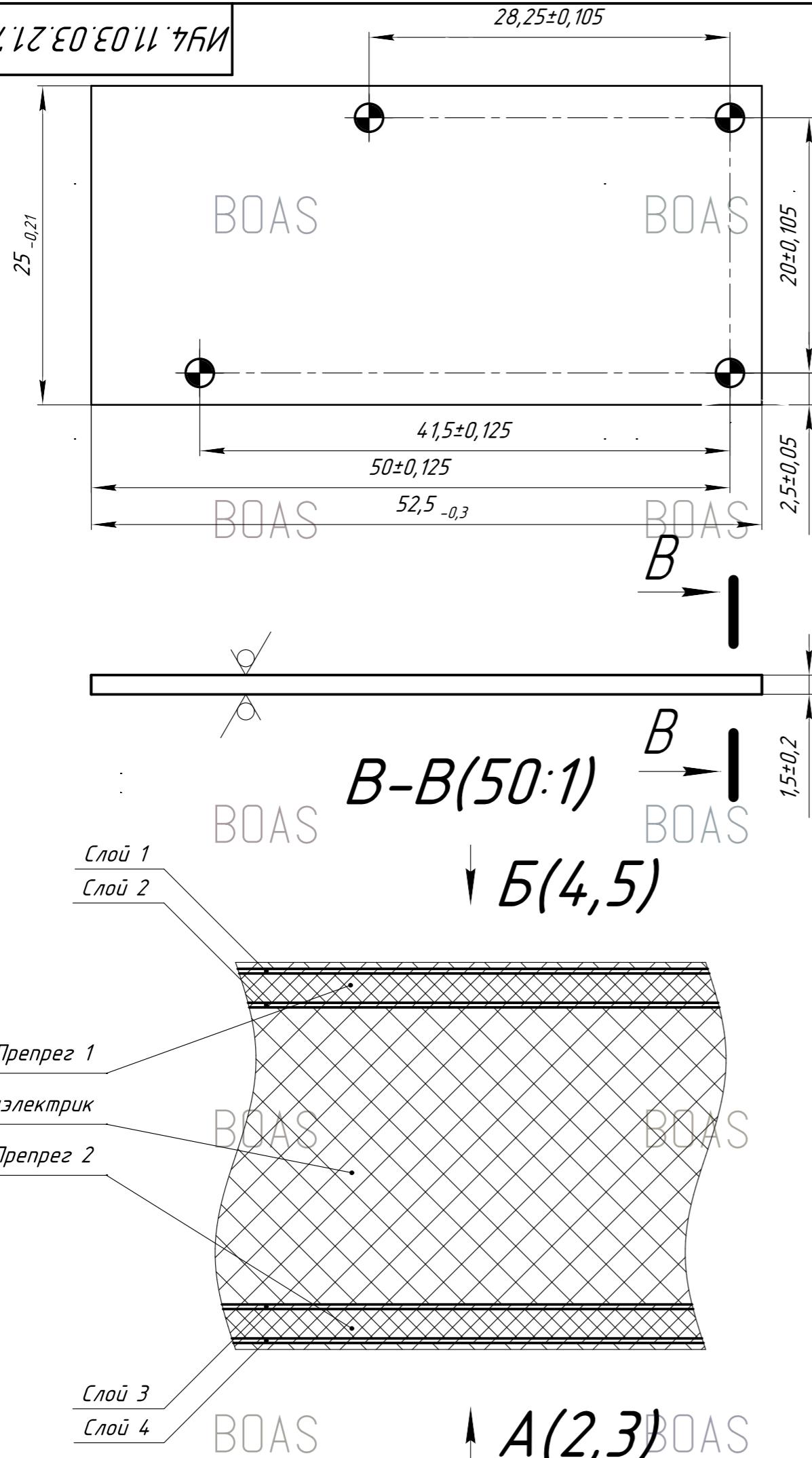


Условное обозначение отв.	Диаметр отв., мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие metallизации	Кол. отв.
	0,3 <sub>-0,1</sub>	0,7	Да	141
	0,6 <sub>-0,13</sub>	1,0	Да	2
	2,2 <sup>+0,05</sup> <sub>-0,18</sub>	2,6	Да	4

$\checkmark Ra\ 25(\checkmark)$

## Таблица



1. На главном виде проводящий рисунок условно не показан.
  2. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-2002 - класс точности Н.
  3. Шаг координатной сетки 0,25мм по ГОСТ Р 51040-97.
  4. Плату изготовить методом сквозной металлизации.
  5. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 - 3.
  6. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
  7. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости - 1.
  8. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не более 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоеем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
  9. Контроль электрической целостности по ГОСТ 23752-92.
  10. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

ИУ4.11.03.03.21.73.16.002

BOAS

BOAS

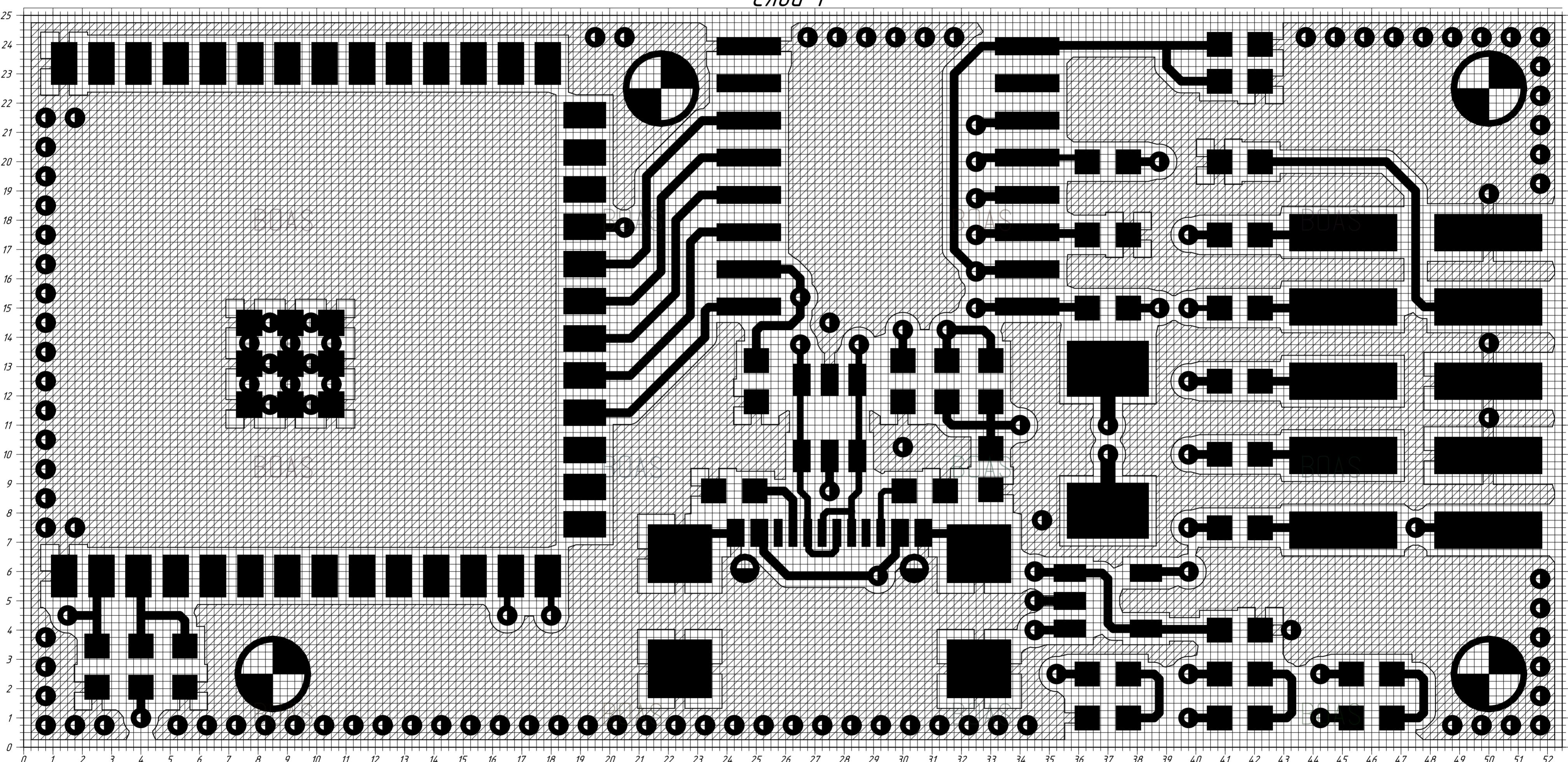
BOAS

*A(10:1)(1)*  
Слой 1

BOAS

Изм/Лист	№ докум.	Подп. Дата

ИЧ4\_11.03.03.21.73.16.002

лист  
2

Изм/Лист	№ докум.	Подп. Дата

BOAS

Копировал

формат А2

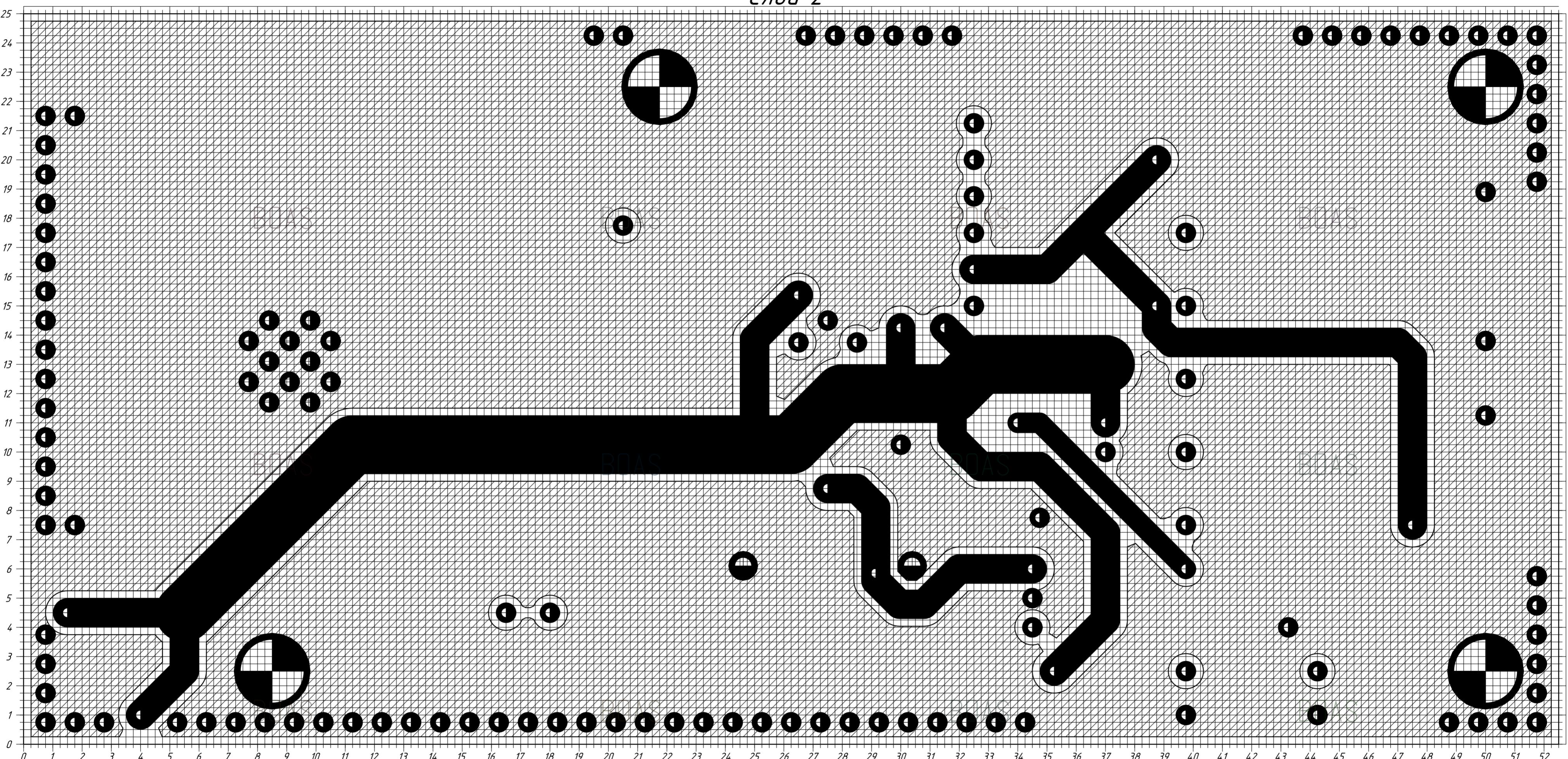
BOAS

BOAS

BOAS

*A(10:1)(1)*  
Слой 2

BOAS



Б(10:1)(1)  
Слой 3

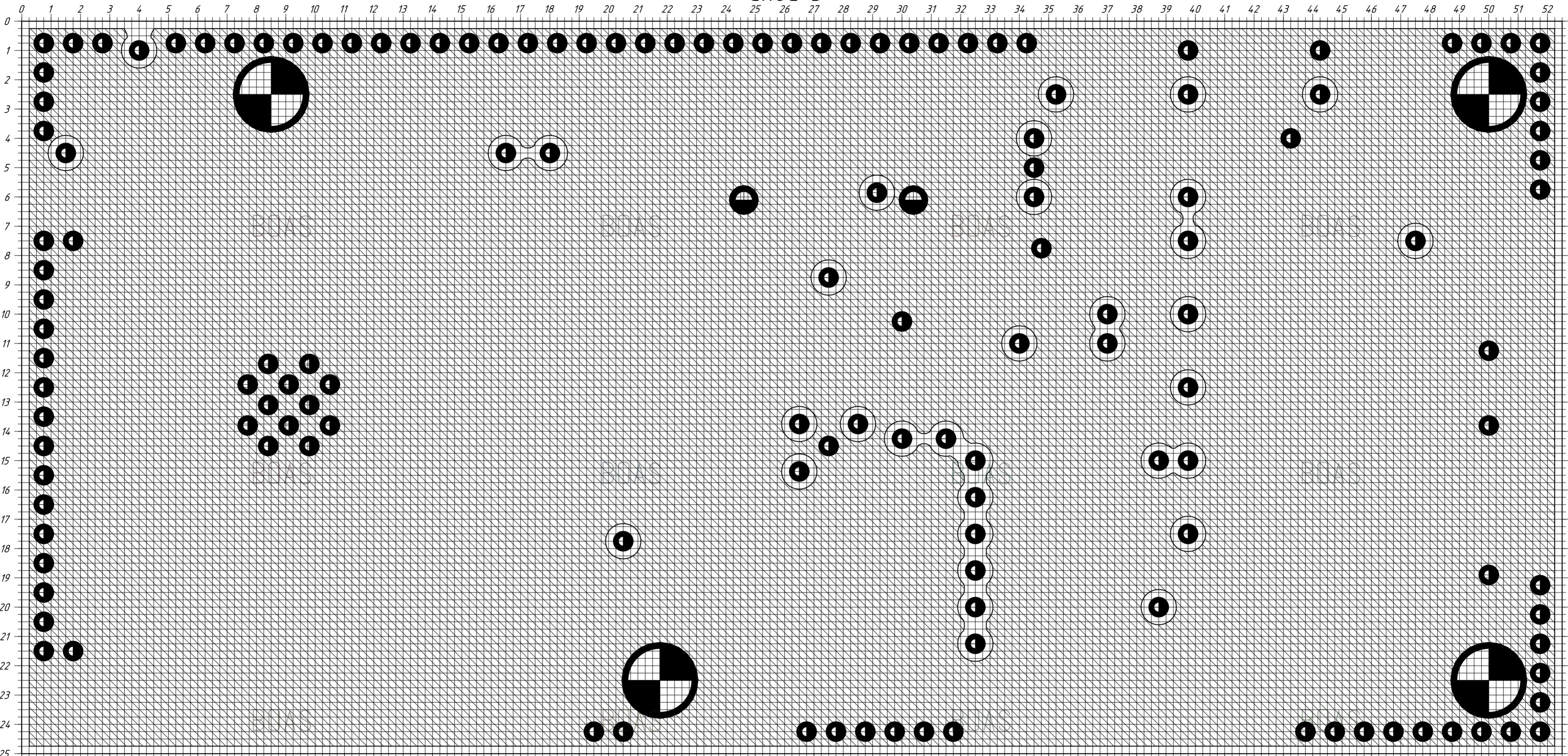
BOAS

BOAS

BOAS

BOAS

BOAS



ИЧ. № подл.	Подп. и дата	Взам. ич. №	ИЧ. № подл.

Изм/лист	№ докум.	Подп. Дата

ИУ4\_11.03.03.21.73.16.002

лист  
4

BOAS

BOAS

BOAS

BOAS

формат А2

Копировано

BOAS

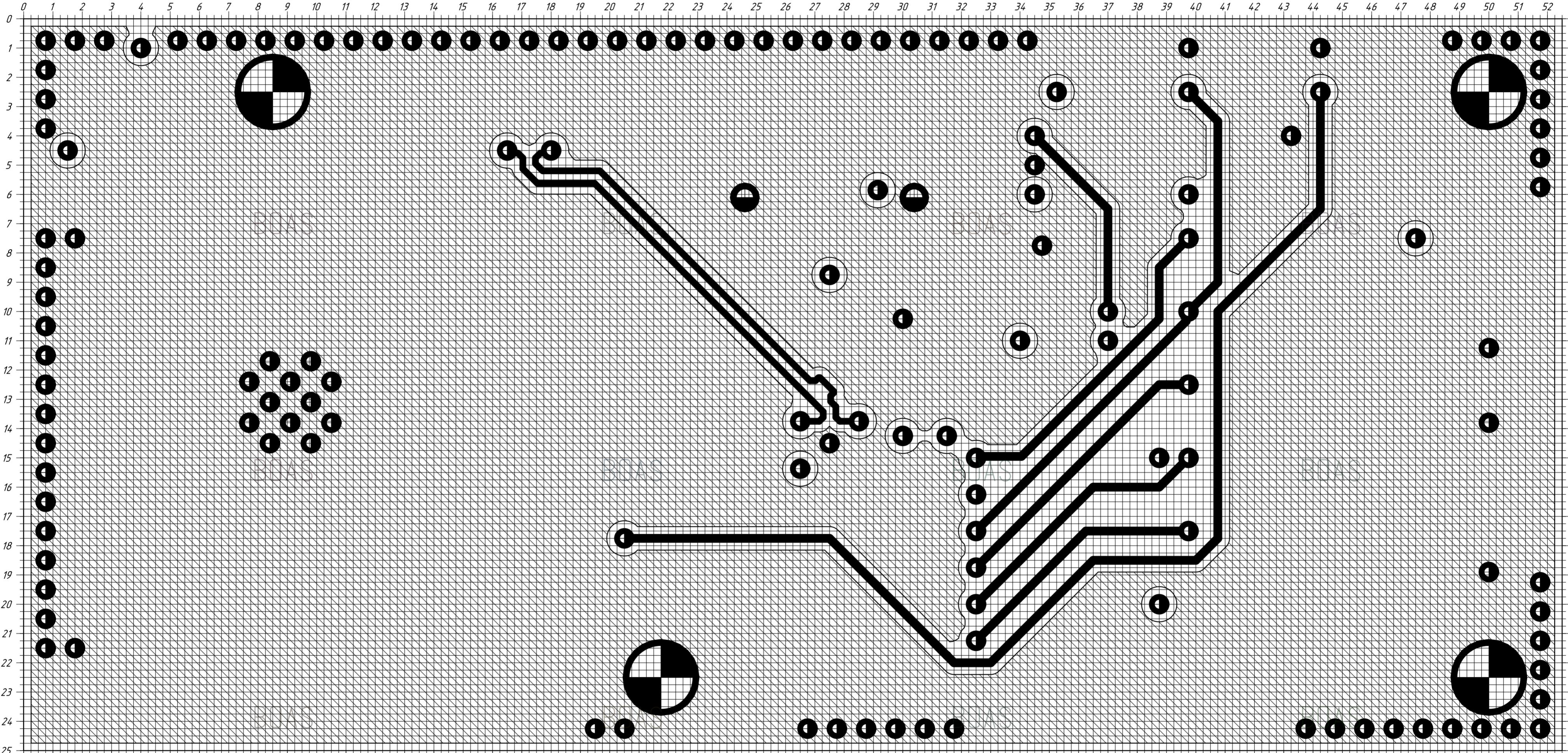
BOAS

BOAS

**Б(10:1)(1)**  
СЛОЙ 4

BOAS

BOAS



ИЧ4 № подл.	Подп. и дата	Взам. ич4.	ИЧ4 № подл.	Подп. и дата
-------------	--------------	------------	-------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата
------	------	----------	------------

ИЧ4\_11.03.03.21.73.16.002

лист	5
------	---

BOAS

BOAS

BOAS

BOAS